

锦州神工半导体股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料



二〇二六年八月

目录

锦州神工半导体股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知	3
锦州神工半导体股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程	5
议案一： 《关于拟投资建设新项目的议案》	7

锦州神工半导体股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《锦州神工半导体股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2026 年第三次临时股东会会议须知：

一、本次股东会由董事会秘书协调组织，公司证券办公室严格按照程序安排会务工作。为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止。

二、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应提前向股东会会务组进行登记。股东会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确

定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不宜过长。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场进行见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会结束后再离开会场。对干扰会议政策程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 7 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

锦州神工半导体股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- （一）会议时间：2026 年 8 月 12 日（周三）14:00
- （二）会议地点：锦州市太和区中信路 46 号甲公司会议室
- （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 12 日至 2026 年 8 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料；
- （二）会议主持人宣布会议开始，并向会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数、介绍现场会议参会人员、列席人员；
- （三）宣读股东会会议须知；
- （四）推举计票、监票成员；
- （五）与会股东审议以下会议议案；

序号	非累积投票议案名称
1	《关于拟投资建设新项目的议案》

- （六）与会股东或股东代表发言、提问；
- （七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决；
- （八）休会，统计现场表决结果；
- （九）复会，主持人宣布会议表决结果；
- （十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书；
- （十一）与会人员签署会议记录等相关文件；

（十二）会议结束。

议案一：

《关于拟投资建设新项目的议案》

各位股东和股东代表：

一、投资建设项目的概述

（一）投资概况

本次开展新项目是基于公司长期发展的战略规划，有助于强化公司核心竞争力并优化公司业务结构，可以满足公司长期发展及生产经营需要，进一步提升公司产业化能力和综合竞争力。本项目拟投资总额约为 **112,992.14** 万元人民币（以实际投入为准）。

本次项目将与公司现有生产体系、再融资募投项目形成产业协同布局。公司将结合整体发展规划、各项目的建设优先级与资金需求，统筹安排建设时序与资金投放节奏，合理控制年度资本开支规模，保障公司经营稳健与资金使用效率。

（二）投资的决策与审批程序

公司第三届董事会战略委员会第五次会议与第三届董事会审计委员会第十五次会议已审议通过《关于拟投资建设新项目的议案》，并将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及管理层在符合相关法律法规、规范性文件及公司章程规定、不改变项目核心投资方向的前提下，结合项目实际推进情况、市场环境变化、公司资金储备状况、整体战略布局及再融资募投项目实施节奏，全权办理本次投资项目的全部相关事宜（包括但不限于：调整项目的投资节奏、分期投入计划与具体投资金额等事项）。

（三）不涉及关联交易和重大资产重组事项的说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、投资建设项目的的基本情况

（一）项目基本情况

1. 硅零部件新品研发及配套硅材料扩产项目

项目实施主体：锦州神工半导体股份有限公司

项目实施地点：辽宁省锦州市及异地

项目主要内容：硅零部件新品研发及配套硅材料扩产的土地厂房及生产线建设、设备购置安装及其他。

项目投资规模及来源：本项目拟投资金额为 58,649.80 万元（以实际投入为准），资金来源为公司的自有及自筹资金。

项目建设周期：5 年

2. 集成电路制造关键材料研发及产业化项目

项目实施主体：锦州神工半导体股份有限公司

项目实施地点：辽宁省锦州市

项目主要内容：集成电路制造关键材料研发及产业化的土地厂房及生产线建设、设备购置安装及其他。

项目投资规模及来源：本项目拟投资金额为 32,562.63 万元（以实际投入为准），资金来源为公司的自有及自筹资金。

项目建设周期：3 年

3. 封装及微纳光电用硅材料新品研发及产业化项目

项目实施主体：锦州神工半导体股份有限公司

项目实施地点：辽宁省锦州市

项目主要内容：封装及微纳光电用硅材料新品研发及产业化的土地厂房及生产线建设、设备购置安装及其他。

项目投资规模及来源：本项目拟投资金额为 21,779.71 万元（以实际投入为准），资金来源为公司的自有及自筹资金。

项目建设周期：2 年

（二）项目建设的必要性和可行性分析

当前半导体产业快速迭代，封装、微纳光电领域硅基材料需求持续扩容，高端硅零部件国产替代空间广阔。公司现有产能与产品品类难以充分覆盖下游客户多元化、高端化采购需求，产能供给、新品研发能力存在短板。本次三大项目同步布局，能够补齐和完善公司集成电路材料全品类产品矩阵，抓住国产替代行业机遇，提升高端半导体材料自主供给能力，巩固行业市场份额，支撑企业长期战略发展。

公司深耕硅零部件多年，拥有成熟研发团队、稳定下游客户资源与成熟生产工艺，具备新材料研发、规模化量产的技术积淀。项目选址主要位于锦州，本地半导体产业配套完善，产业政策支持力度充足；资金来源为自有及自筹资金，配套融资渠道通畅。各项目分周期分步建设，长短期产能有序释放，研发、产线建设方案经过充分论证，技术、场地、资金、市场条件均具备落地实施基础，项目具备较强可实施性。

三、投资建设项目对公司的影响

本次开展新项目是基于公司长期发展的战略规划，有助于强化公司核心竞争力并优化公司业务结构，可以满足公司长期发展及生产经营需要，进一步提升公司产业化能力和综合竞争力。公司对本次投资建设新项目进行了充分的可行性和论证。本项目无其他投资方，公司为唯一实施主体，由公司统筹实施，如后续存在通过子公司实施或其他投资方参与的情形，将根据相关法律法规的有关规定，及时履行信息披露义务。本次投资预计不会对公司正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益情形。

四、投资建设项目的风险分析

1、公司目前核心业务为大直径硅材料、硅零部件业务，产品主要应用于硅零部件设备厂商、下游半导体刻蚀设备等半导体设备厂商、终端存储芯片制造厂商等。本项目系围绕目前产品技术路线，拓展现有业务并开拓新产品，增加新的市场应用。如果该项目因研发进展、技术经验不足而无法实施、延期实施，或产品质量、客户开拓未达预期，则可能影响项目投资进展及预期收益的实现。

2、本项目实施需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本次投资所需资金来源于公司自有资金与自筹资金。倘若后续发生宏观经济、行业相关政策、市场行情或自身经营情况出现负面变动，或出现公司其他在建、拟建项目（含再融资募投项目）的资金需求发生变化等情况，进而造成公司自有资金储备不足、自筹融资渠道收紧、融资成本走高，则本次投资项目或将出现建设进度滞后、工期延后、方案变更、暂停乃至完全终止的情形，同时公司整体财务经营状况也可能因此承受负面影响。

4、本次投资建设项目系基于公司战略发展及现阶段市场环境、行业发展趋

势等多重考量后确定实施。项目实际落地推进，还将受制于下游客户认证测试进度、行业市场需求波动、行业竞争态势等各类外部与内部条件。

5、本项目投资规模、建设周期等均为预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

6、后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

7、若前述任一因素发生负面变动，均有可能造成项目投资规划、建设实施进度、产能投放节奏及预期收益难以达成，继而对公司后续经营业绩、产能布局落地及中长期整体发展规划形成不利冲击，提请各位投资者充分留意项目推进及相关市场层面的潜在风险。

本议案已于 2026 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日